Доклады Академии наук СССР 1972. Том 206, № 3

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Г. К. АВЕРКИЕВА, В. Д. ПРОЧУХАН, М. ТАШТАНОВА

О ВЛИЯНИИ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ СТЕХИОМЕТРИИ НА СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКА ZnSiAs₂

(Представлено академиком В. М. Тучкевичем 8 II 1972)

Перспективные для практических применений полупроводники типа $A^2B^4C_2^{\ 5}$ обладают более нирокой областью гомогенности, чем их бинарные электронные аналоги типа A^3B^5 . В связи с этим внешние условия при термической обработке или в процессе роста кристаллов $A^2B^4C_2^{\ 5}$ оказывают на их полупроводниковые свойства более существенное влияние. Подобного рода исследования, выполненные на монокристаллах $CdSiAs_2$, показали, что концептрация свободных носителей заряда в этом полупроводнике может быть изменена в пределах нескольких порядков (4 , 2). В то же время кристаллы $ZnSiAs_2$ — одного из наиболее широкозонных полупроводников типа $A^2B^4C_2^{\ 5}$, полученные рядом автором, не были исследованы в этом аспекте (3 , 4).

Нами было изучено влияние химического состава расплава и температуры кристаллизации на свойства кристаллов ZnSiAs₂. Результаты приведены в табл. 1, из данных которой видно, что при фиксированном химическом составе растворителя концентрация дырок в ZnSiAs₂ падает при понижении температуры кристаллизации, причем подвижность дырок после некоторого увеличения также начинает уменьшаться. По-видимому, пони-

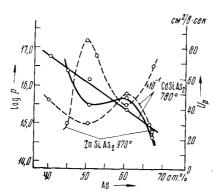


Рис. 1. Зависимость концентрации и подвижности дырок в кристаллах ZnSiAs₂ и CdSiAs₂ от содержания мышьяка в растворителе. Сплошные кривые — концентрация дырок, пунктирные — подвижность дырок

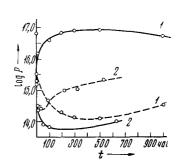


Рис. 2. Зависимость концентрации дырок в кристаллах ZnSiAs₂ (2) и CdSiAs₂ (1) от времени отжига. Сплошные кривые — отжиг в парах аниона, пунктирные — отжиг в парах катиона

жение температуры кристаллизации сопровождается увеличением количества точечных дефектов и степени компенсации полупроводника ZnSiAs₂. При фиксированной температуре кристаллизации концентрация и подвижность дырок зависят от содержания мышьяка в растворителе, причем в целом наблюдается тенденция к уменьшению концентрации дырок при увеличении содержания мышьяка. Результаты экспериментов на ZnSiAs₂ гра-

Растворитель			- 45		$v_{\rm p}$,
Zn, ar.%	Аз, ат.%	Подпитка	T _{Kp} , ℃	P, cm ⁻³	см²/сек
33,3	66,7	Si	980	$ \begin{array}{r} 1 \cdot 10^{15} \\ 5 \cdot 10^{14} \\ 4 \cdot 10^{14} \\ 2 \cdot 10^{14} \end{array} $	60
33,3	66,7	Si	970		70
33,3	66,7	Si	960		50
33,3	66,7	Si	900		30
40	60	Si	970	5·10 ¹⁵	40
40	60	Si	960	3·10 ¹⁵	55
40	60	Si	900	6·10 ¹⁴	15
44,5	55,5	SiAs	960	$1 \cdot 10^{15}$ $3 \cdot 10^{15}$ $1 \cdot 10^{15}$	65
50	50	SiAs	970		85
50	50	SiAs	900		50
55,5	44,5	SiAs	970	3·10 ¹⁶	30

фически сопоставлены на рис. 1 с дапными такого рода, полученными при исследовании $CdSiAs_2$ авторами (¹). Как видно, для обоих соединений характерна тенденция к уменьшению равповесной концентрации дырок при увеличении содержания аниона в расплаве. Эта особенность соединений типа $A^2B^4C_2^5$ связана с амфотерностью элемента IV группы, иными словами, с размещением некоторой части атомов кремния в узлах мышьяка или элемента II группы. Нелинейный характер изменения концентрации и подвижности дырок в $ZnSiAs_2$ приводит к мысли о сложной природе

химических сдвигов, имеющих место при изменении химического состава растворителя. Помимо указанных выше дефектов, сле-

помимо указанных выше дефектов, следует принять во внимание возможность образования вакансий, например, в узлах цинка и мышьяка. Интересно отметить, что кривые изменения подвижности в кристаллах CdSiAs₂ и ZnSiAs₂ являются зеркальным отображением друг друга. Это обстоятельство приводит к мысли о разном характере процессов, развивающихся в рассматриваемых соединениях.

Для подтверждения сказанного можно сопоставить результаты выполненных нами исследований влияния термической обработки кристаллов ZnSiAs₂ в различных средах с подобными результатами, полученными авторами (²) на кристаллах CdSiAs₂. Как видно из рис. 2 и 3, на которых представлено изменение концентрации и подвижности дырок, кривые концентрации в CdSiAs₂ и ZnSiAs₂ в общих чертах являются зеркальным отображением друг друга, в то время как кривые подвижности по своему характеру имеют относительное сходство. Поэтому можно предполо-

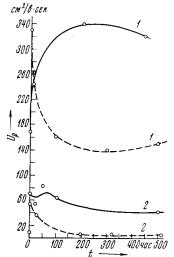


Рис. 3. Зависимость подвижности дырок в соединении ZnSiAs₂ (2) и CdSiAs₂ (1) от времени отжига. Обозначения те же, что на рис. 2

жить, что в обоих соединениях при термической обработке количество дефектов изменяется примерно одинаково, однако их электрическое действие различно.

Сопоставляя кривые изменения концентрации и подвижности дырок, можно объяснить их форму, например, такой моделью процессов: на первых стадиях отжига в парах мышьяка в CdSiAs₂ происходит «залечивание»

вакансий в узлах As, а в ZnSiAs₂ — замещение кремнием узлов ципка, что приводит к возрастанию концентрации и подвижности дырок в первом случае, в то время как во втором случае уменьшается только концентрация дырок при небольших колебаниях подвижности. На второй стадии отжига в CdSiAs₂ сказывается обладающий, по-видимому, большой энергией активации процесс удаления амфотерного кремния из анионной подрешетки и образование вакансий в узлах кадмия, а в ZiSiAs₂ — процесс образования вакансий в узлах ципка, что приводит к медленному падению концентрации и подвижности дырок в первом случае, в то время как во втором случае концентрация медленно повышается, а подвижность так же медленно падает. Подобным образом можно объяснить и кривые, соответствующие отжигу в парах элементов II группы.

Однако для достоверной интерпретации полученных данных необходимо более детальное исследование явлений и более полные сведения о знаке и величине эффективных зарядов атомов, слагающих решетку халькопирита $(^5, ^6)$. Кроме того, предложенная модель не учитывает возможности внедрения атомов в междоузлия. Тем не менее, существенное и закономерное изменение свойств полупроводников типа $A^2B^4C_2^5$ в зависимости от внешних условий доказано экспериментально.

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Академии наук СССР Лепинград Поступило 1 II 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ Г. К. Аверкиева, Н. А. Горюнова и др., ДАН, 191, № 4, 811 (1970). ² С. К. Аverkieva, N. А. Goryunova et al., Phys. Status Solidi. (a). 5, 571 (1971). ³ Д. Э. Снелл, Г. Д. Баррелл и др., Матер. IX Международн. конфер. по полупроводникам в Москве, 1968 г., 2, Л., 1969, стр. 1297. ⁴ А. J. Spring-Thrope, R. W. Monk, Physica Status Solidi (a), 1, № 1 (1970). ⁵ V. K. Yarmarkin, V. S. Grigoreva, V. D. Prochukhan, Phys. Status Solidi (b), 48, 129 (1971). ⁶ V. K. Yarmarkin, L. V. Kradinova, V. D. Prochukhan, Physica Status Solidi (a), 5, № 2 (1971).